

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2026-076

合肥新汇成微电子股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“汇成股份”）董事会编制了 2026 年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号），本公司由主承销商采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 11,487,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 1,148,700,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 3,500,000.00 元(不含税)后的募集资金为 1,145,200,000.00 元，已由主承销商于 2024 年 8 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,672,108.48 元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 1,142,527,891.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕336 号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2024 年 8 月 13 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	114,870.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	617.21
二、募集资金净额	114,252.79
减：	
以前年度已使用金额	112,330.08
本年度使用金额	2,032.41
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	2.63
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	112.33
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2024年8月分别与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限

公司合肥分行、中国银行股份有限公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州分行、广发银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

发行名称			2024 年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2024 年 8 月 13 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
合肥新汇成微电子股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥瑶海支行	8112301013201026778		已注销
	招商银行股份有限公司合肥分行营业部	514902669010002		已注销
	浙商银行股份有限公司合肥分行营业部	3610000010120100588108		已注销
	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100100460563		已注销
江苏汇成光电有限公司	中国银行股份有限公司扬州邗江支行	520980997944		已注销
	招商银行股份有限公司扬州邗江支行	514902342810000		已注销
	广发银行股份有限公司扬州分行营业部	9550880246966300186		已注销

注：公司存放于上述专户的募集资金已按规定用途全部使用完毕，并完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构及上述募集资金专用账户开户银行或其具有签订募集资金监管协议权限的上级分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金具体使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

由于本次公开发行实际募集资金净额114,252.79万元少于《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟投入募集资金金额114,870.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据可转债发行时对董事会的授权，结合公司实际情况，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后的投资总额见附件1。

公司于2024年8月16日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司不特定对象发行可转换公司债券募投项目“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”的实施主体为全资子公司江苏汇

成公司，公司拟使用募集资金30,000.00万元人民币向江苏汇成增资用于实施上述募投项目。此外，公司拟使用募集资金向江苏汇成提供20,000.00万元人民币借款。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-077）。截至2026年06月30日，公司使用募集资金向江苏汇成公司累计提供借款20,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，报告期内不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年8月13日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称			2024 年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2024 年 8 月 13 日										
本年度投入募集资金总额			2,032.41										
已累计投入募集资金总额			114,362.49										
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
12 吋先进制程新型	生产	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2,032.41	35,077.10	77.10	100.22	2026 年	-	不适	否

[illegible]

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三（八）之说明

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：补充流动资金项目性质为“其他”，该补流账户资金部分用于支付发行费用，部分用于补充流动资金。

注 4：“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”和“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”是以本公司及江苏汇成为实施主体，是本公司及江苏汇成利用现有厂区，在现有技术及工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后，本公司及江苏汇成 12 吋先进制程新型显示驱动芯片金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装产能将大幅提升。